
Kontaktstift 0.63 x 0.63 mit ACTION PIN
Pin 0.63 x 0.63 with ACTION PIN

Inhaltsverzeichnis

Table of contents

1. ZWECK	1. PURPOSE
2. ZUSÄTZLICHE UNTERLAGEN	2. ADDITIONAL DOCUMENTS
2.1 Kundenzeichnung	2.1 <i>Customer Drawing</i>
2.2 Produktspezifikation	2.2 <i>Product Specification</i>
2.3 Prüfvorschrift	2.3 <i>Test Specification</i>
3. BESCHREIBUNG	3. DESCRIPTION
3.1 ACTION PIN	3.1 <i>ACTION PIN</i>
4. ANFORDERUNGEN	4. REQUIREMENTS
4.1 Leiterplatte	4.1 <i>Printed Circuit Board</i>
4.2 Einpresslöcher	4.2 <i>Printed Circuit Board Holes</i>
4.3 Verarbeitungsmaße	4.3 <i>Processing Dimensions</i>
4.3.1 Positionstoleranz Leiterplatte	4.3.1 <i>Position Tolerance Printed Circuit Board</i>
4.3.2 Stiftmaße	4.3.2 <i>Pin Dimensions</i>
4.3.3 Verdrehwinkel	4.3.3 <i>Twist Angle</i>
4.4 Einpressgeschwindigkeit und Einpresskraft	4.4 <i>Press-in Speed and Insertion Force</i>
4.4.1 Beispiel: Verarbeitungsmaschine P300	4.4.1 <i>Example: Processing Machine P300</i>
5. TE Connectivity VERARBEITUNGSWERKZEUGE	5. TE Connectivity PROCESSING TOOLS

1. ZWECK
Purpose

Diese Spezifikation beinhaltet die Richtlinien zur Verarbeitung des ACTION PIN Kontaktes.

This specification contains the guidelines to process the ACTION PIN contact.

2. ZUSÄTZLICHE UNTERLAGEN
ADDITIONAL DOCUMENTS

2.1 Kundenzeichnung
Customer drawing

Maße, Werkstoffe und Oberflächen sind der Kundenzeichnung zu entnehmen.

The customer drawing shows the dimensions, materials and surfaces.

2.2 Produktspezifikation
Product Specification

In der Produktspezifikation 108-18643 sind die elektrischen und mechanischen Eigenschaften des Kontaktes beschrieben.

The electrical and mechanical characteristics of the contact are described in the Product Specification 108-18643.

2.3 Prüfvorschrift
Test Specification

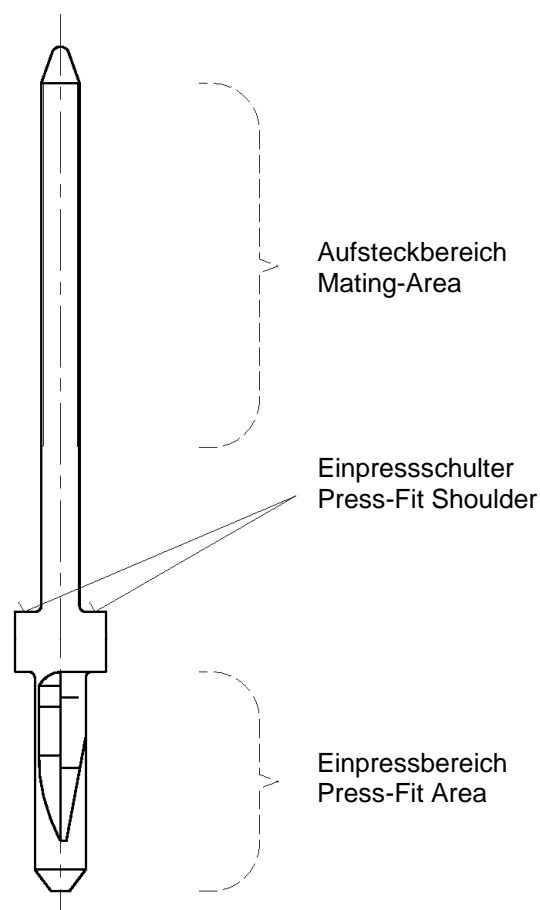
siehe Produktspezifikation 108-18643

see Product Specification 108-18643

3. BESCHREIBUNG DESCRIPTION

3.1 ACTION PIN ACTION PIN

Der ACTION PIN besteht aus dem Einpressbereich für Leiterplatten von 1.6 mm Dicke und dem Aufsteckbereich für Buchsenkontakte.
The ACTION PIN consists of the Press-Fit Area for Printed Circuit Board of 1.6mm thickness and the Mating-Area for socket contacts.



4 ANFORDERUNGEN REQUIREMENTS

4.1 Leiterplatte Printed Circuit Board

Leiterplattenanforderungen sind in der Produktspezifikation 108-18643 zu entnehmen.

Printed Circuit board requirements can be found in product specification 108-18643.

4.2 Einpresslöcher Printed Circuit Board Holes

Fehlende Maße für den Lochaufbau wie z.B.:

For missing dimensions for the layout of the holes such as i.e.:

- Lochdurchmesser
- Cu Schichtdicke
- Sn Schichtdicke

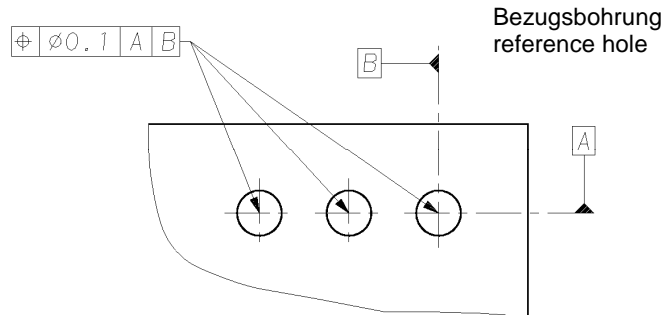
- *hole diameter*
- *Cu layer thickness*
- *Sn layer thickness*

siehe Kundenzeichnung.
see customer drawing.

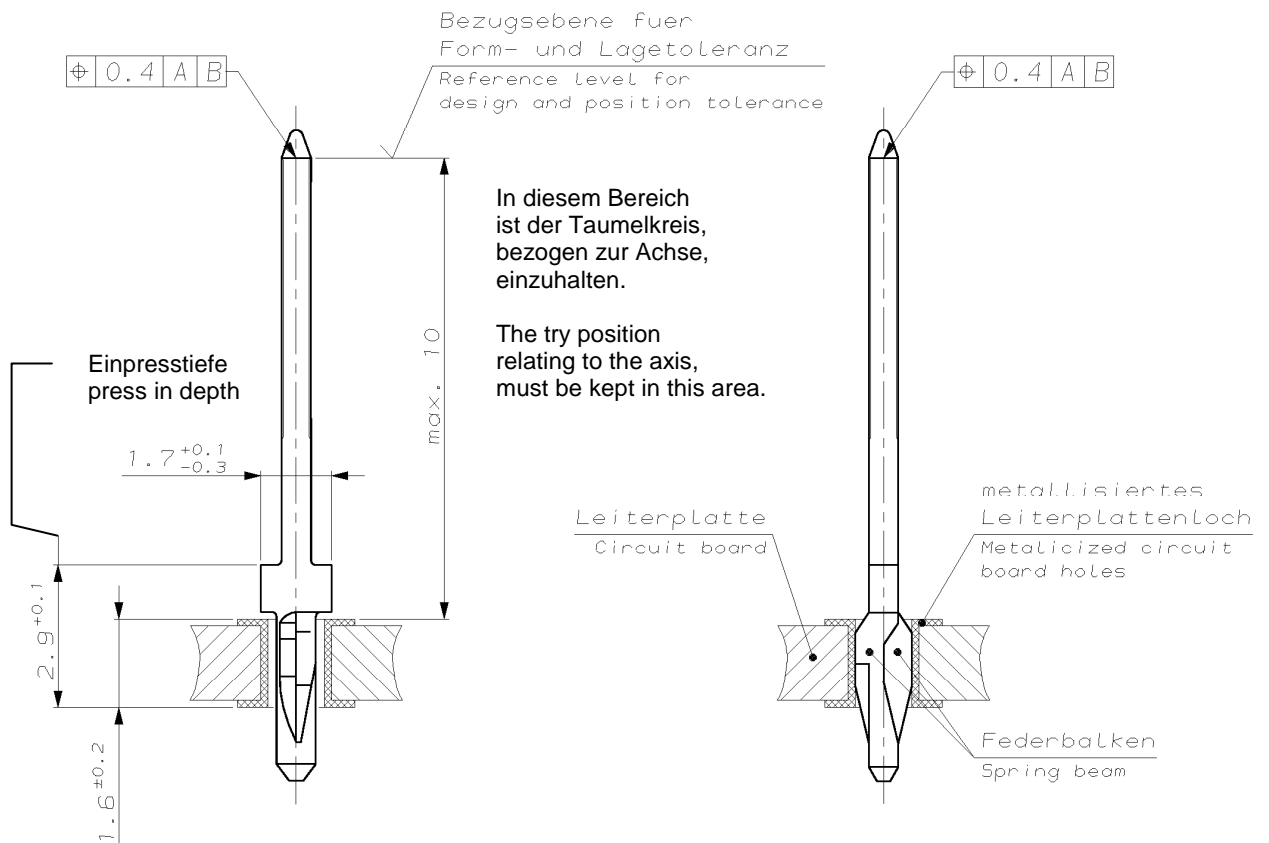
4.3 Verarbeitungsmaße Processing Dimensions

Fehlende Maße siehe Kundenzeichnung.
Missing dimensions see customer drawing.

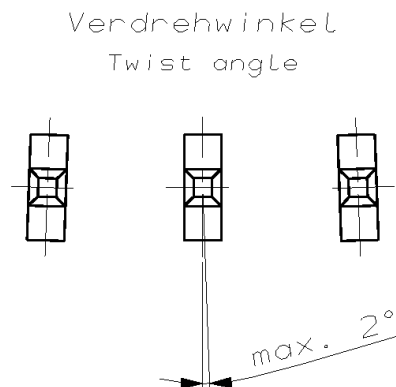
4.3.1 Positionstoleranz Leiterplatte Position Tolerance Printed Circuit Board



4.3.2 Stiftmaße Pin Dimensions



4.3.3 Verdrehwinkel Twist Angle



4.4 Einpressgeschwindigkeit und Einpresskraft Press-in Speed and Insertion Force

Abhängig von der Anwendung und Ausführung ergeben sich verschiedene Werte, deshalb Beispiel in Tabelle 4.4.1 beachten.

Wenn keine vergleichbaren Beispiele enthalten sind, muss der Anwender den Einzelfall testen bzw. prüfen lassen.

The different values are dependent on the application and execution; therefore, observe the example in table 4.4.1.

If no comparable examples are present, the user must have the individual case tested or checked.

4.4.1

Beispiel der Verarbeitung mit P300 X Y Einsetzmaschine	
Eindrückkraft	Geschwindigkeit
60 N bis 180 N	max. 200 mm/sec

Example of processing with P300 X Y insert machine	
Insertion Force	Press-in Speed
60 N bis 180 N	max. 200 mm/sec

5. **TE Connectivity VERARBEITUNGSWERKZEUGE** *TE Connectivity PROCESSING TOOLS*

Unterlagen und Spezifikationen der Einsetzmaschinen sind über den Hersteller anzufragen.

Documents and specifications for inserting machines need to be requested from the manufacturer.